

本集團之業務發展

緒言

我們的執行董事Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生，（連同Chow Hin Keong先生統稱「周氏兄弟」）為我們的共同創辦人。Chow Hin Keong先生於半導體行業擁有逾25年的貿易及生產經驗。Chow Hin Keong先生於一九八九年加入一間半導體生產商擔任營銷主管，負責半導體的銷售及市場營銷以及與客戶及供應商聯繫，自此開啟了其於半導體行業之事業。

憑藉其於工作中獲得的半導體行業經驗，Chow Hin Keong先生於一九九四年在馬來西亞檳城成立了自己的電子元器件貿易及進出口公司SAG Components Sdn Bhd（「SAG」）。SAG主要從事多種電子元器件的貿易，包括但不限於諸如可用於顯示器、電源設備、移動電話及電子設備的二極管、橋式整流管及三極管。其亦從事非半導體之其他電子元器件產品之貿易，如壓敏電阻、保險絲、陶瓷及聲表面波諧振器／濾波器、感應器／線圈、喇叭、接頭及開關等。其客戶主要包括馬來西亞、新加坡及印尼之公司。於一九九五年較後時間，Chow Hin Keong先生之胞弟Chow Hin Kok先生加入SAG擔任銷售經理以協助Chow Hin Keong先生發展業務。周氏兄弟此後聯手發展彼等之電子元器件業務。SAG曾作為一間馬來西亞二極管公司獲得某行業雜誌一九九六年六月刊認可。

由SAG採購及買賣之產品銷售予東南亞客戶，並無特別專注於中國。周氏兄弟於從事該行業期間，已認識到中國及韓國擁有巨大的半導體業務發展潛力。鑒於中國與香港之密切聯繫，周氏兄弟因此決定於香港建立獨立的公司，以期最終於中國設立生產設施。因此，周氏兄弟於二零一二年十二月十四日利用自有資源共同創辦了本集團，當時彼等已創辦泰邦企業並開始進行電子元器件貿易。其後於二零一三年四月二十七日，我們於中國建立了生產部門東莞佳駿，而我們位於中國廣東省東莞市松山湖的生產設施亦於同年九月開始組裝及封裝分立半導體業務。

歷史、重組及集團架構

SAG之總部位於馬來西亞檳城。其業務重點與本集團不同，(i)就半導體而言，其主要進行採用第二代或以下生產技術之產品之交易；(ii)其不止進行半導體貿易，亦交易各類電子元器件，如壓敏電阻、保險絲、陶瓷及聲表面波諧振器／濾波器、感應器／線圈、喇叭、接頭及開關等；以及(iii)其並無從事任何自行生產業務。而本公司之總部乃位於香港且主要生產設施位於中國。我們的人員主要來自香港及中國。除周氏兄弟外，我們的人員概無參與SAG的業務經營。我們的具體業務專注於技術先進的半導體產品，其中若干乃由我們生產。為專注於本集團之業務（包括但不限於專注於技術先進的產品及銷售自行生產產品），周氏兄弟於二零一四年出售彼等各自於SAG的全部股份予SAG的一名管理人員（彼當時為SAG少數股東）及其聯屬人士（為獨立第三方）。周氏兄弟自此不再於SAG或其業務中擁有任何權益。截至二零一三年十二月三十一日止年度（即周氏兄弟出售SAG之前一年），據SAG的經審核賬項可知，SAG錄得除稅前溢利淨額約15,000馬幣（相當於約35,000港元）及除稅後虧損淨額約8,700馬幣（相當於約20,000港元）。周氏兄弟確認，就彼等之所深知及盡信SAG於周氏兄弟出售前並無涉及任何適用法律及法規之重大不合規、法律索償或訴訟。

ST品牌

泰邦企業於二零一二年十二月成立。Chow Hin Keong先生已考慮多種途徑以最高效及有效率的方式建立及發展我們的業務。由於Chow Hin Keong先生已於業內累積相關經驗及建立起相關業務聯繫，彼認為獲認可的成熟品牌對我們的產品而言非常有幫助，將有利於其快速向市場滲透。就此而言，Chow Hin Keong先生與SAG的一間長期供應商超偉企業有限公司（「超偉」）（其為股份於聯交所上市的泰豐國際集團有限公司（「泰豐」，前稱為先科國際集團有限公司，連同其附屬公司統稱「泰豐集團」）的全資附屬公司）接洽，以商討一項安排，據此，彼可透過許可使用、收購權益、合營企業或其他方式取得「ST」品牌的利益。就董事所深知，超偉主要向SAG提供玻封二極管（如DO34/35、LS31、LL34、DO41）以及三極管（如TO92），其均採用第二代或以下之封裝技術。

歷史、重組及集團架構

根據公開可得資料，超偉主要從事電子及電氣部件及零件的生產及貿易，且已銷售其「ST」品牌項下產品已逾10年。由於Chow Hin Keong先生曾希望對其使用「ST」品牌擁有控制權，確定使用期限以及使用方式，彼排除了獲得使用許可或與超偉建立一間合營企業的可能性，這兩種方式於一般情況下均為固定期限，以及可於任何時間由訂約方終止。因此，於二零一三年五月，Chow Hin Keong先生自泰豐一間附屬公司收購其於先科電子的50%股權，該附屬公司並無經營業務，而其唯一資產為總代價為5,000,000港元的先科電子商標。緊接於該項收購前，先科電子之全部已發行股本由泰豐集團所持有。緊隨該項收購後及於最後實際可行日期，先科電子之全部已發行股本分別由Chow Hin Keong先生持有50%及由泰豐一間附屬公司持有50%。根據公開可得資料，先科電子於上述收購後不再入賬為泰豐的附屬公司。Chow Hin Keong先生及泰豐集團各自於先科之董事會佔有一個董事席位。

於有關時間內，訂約方均已同意本集團與泰豐集團可就彼等各自之業務使用先科電子商標。訂約方達成此安排乃因彼等之共識為本集團與泰豐集團所銷售的產品就電流容量、效能、尺寸及應用而言將會有所不同。因此，Chow Hin Keong先生促使先科電子授權本集團於我們的業務中以零代價使用先科電子商標。泰豐集團亦繼續就其業務使用先科電子商標。

董事認為，由本集團及泰豐集團就彼等各自之業務使用先科電子商標乃屬商標註冊擁有人與被授權人達成之許可、授權或類似安排，於行業內並非不常見。成熟品牌之擁有人有時或會授權或許可一間第三方公司（即被授權人）使用其品牌名稱以發展被授權人之業務，而品牌擁有人繼續以相同品牌名稱銷售相同產品。據董事所深知，除向其指定第三方生產商授出許可或授權以生產標註先科電子商標之電子零件產品外，泰豐集團並無與任何除本集團外之訂約方訂立有關使用先科電子商標之任何其他許可、授權或類似安排。根據公開資料，泰豐集團所銷售之產品主要包括普遍適用於機動車、電子產品、消防、照明、家電、電源及充電器以及其它等一系列產品的玻封二極管、三極管及電容器。作為泰豐集團之成員公司，超偉向SAG供應若干種類之玻封二極管及三極管。

歷史、重組及集團架構

我們業務重點特定為技術先進的半導體產品並且我們的半導體產品主要應用於智能手機及高端便攜式電子產品以及相關充電器及電源產品。就我們所知，泰豐集團（包括超偉）所生產及銷售的主要產品與我們的產品於應用、特徵、功能性、生產技術及技術參數等方面存在多項主要差異，如外觀、尺寸、工藝、電流、靜電保護能力等。下表載列我們的產品與泰豐集團（包括超偉）主要銷售產品的差異概要：

	我們的半導體產品	泰豐集團（包括超偉） 所生產及銷售的主要產品
應用	<ul style="list-style-type: none">• 智能手機；• 適配器；• 高端便攜式電子產品，及相關充電器及電源產品；• LED電視機；及• 顯示器等	<ul style="list-style-type: none">• 家用電器；• 通訊設備；• 辦公設備；• 安保；• 照明；• 電子產品；及• 玩具等
特徵	<ul style="list-style-type: none">• 超薄及超小；• 極低泄漏；• 高功率；• 高穩定性；及• 高允通電流及可靠性（符合汽車元器件及部件之AEC-Q101標準）	<ul style="list-style-type: none">• 小型封裝；• 高穩定性；及• 簡易安裝
功能性	<ul style="list-style-type: none">• 主要用作保護元件，如靜電保護二極管；及• 整流管／肖特基整流管／橋式整流二極管	<ul style="list-style-type: none">• 開關二極管；• 穩壓二極管；• TVS二極管；• 肖特基勢壘二極管；及• 三極管等

歷史、重組及集團架構

	我們的半導體產品	泰豐集團（包括超偉） 所生產及銷售的主要產品
生產技術 (附註)	<ul style="list-style-type: none">• 主要採用第三代或以上生產技術	<ul style="list-style-type: none">• 主要採用第一或第二代生產技術
技術參數	<ul style="list-style-type: none">• 用無引腳塑料進行封裝；• 尺寸超薄及超小（如1毫米 x 0.6毫米）；• 倒裝焊接或引線鍵合；• 電流範圍為2安培至3安培；及• 部分半導體產品具最高30千伏之靜電保護能力	<ul style="list-style-type: none">• 以玻璃殼或塑料殼封裝；• 不同尺寸（如就DO35二極管而言，最大58.9毫米 x 1.9毫米）；• 引線鍵合；及• 就TO92三極管而言，電流範圍為0.2安培至5安培

附註：

就討論不同代次產品而言，請參閱本招股章程「行業概覽—分立半導體封裝概覽」。

歷史、重組及集團架構

具體而言，本集團與泰豐集團（以「ST」名稱銷售）生產之主要半導體產品的主要系列於下列幾個方面存在差異：—

	本集團	泰豐集團
SOD/LBF系列	SOD123FL、SOD123HE、SOD323HE、LBF，除SOD323外，均使用倒裝焊接技術生產	並不生產SOD123FL、SOD123HE、SOD323、SOD323HE、LBF。此外，所有SOD產品均使用引線鍵合技術生產
DFN系列	DFN1006及DFN1608	並無生產DFN系列產品
SOT系列	六管腳產品，尺寸小於2.0毫米x1.25毫米x0.95毫米，且屬於三通道產品或二極管陣列產品	三管腳產品，屬於二通道產品或二極管陣列產品
TO系列	尺寸大於4.05毫米x5.3毫米x1.1毫米且電流容量大於10安培	尺寸等於或小於4.05毫米x5.3毫米x1.1毫米，且電流容量等於或小於10安培

「ST」商標的使用

於往績記錄期間，所有自行生產產品及貿易產品的包裝盒上均標有本公司名稱「Top Dynamic」及「ST」商標。由於我們的若干客戶在與我們進行業務之前須取得內部預先批准，我們已於過往接獲彼等之批准時向彼等提呈標有本公司名稱「Top Dynamic」及「ST」商標之賣方申請。由於「Top Dynamic」與「ST」相比對市場而言相對較新，我們相信「ST」商標的出現將增加我們該等申請獲批准的機會。

歷史、重組及集團架構

由於往績記錄期間，我們的大部分產品均標有「Top Dynamic」名稱及「ST」商標，董事確認不可能單獨確認來自「ST」商標之部分收入。儘管我們擬於我們的業務中逐漸減少使用「ST」商標（更多詳情，請參閱下文），考慮到我們業務之利益，我們可能不能於我們的預期時間表內獲得我們若干現有客戶的重新批准（倘需要）或完全摒棄使用「ST」商標。因此，我們訂立轉讓協議收購ST商標。

轉讓協議

為方便上市，並與我們的控股股東之一Chow Hin Keong先生保持經營獨立性，泰邦電子於二零一五年六月十五日訂立轉讓協議，按代價2,600,000港元自先科電子收購ST商標。根據轉讓協議，先科電子已出售並處置其有關ST商標之全部所有權、權利及權益予泰邦電子。緊隨轉讓協議之簽訂，先科電子將不得再使用ST商標或將ST商標授權予任何人士。ST商標由泰邦電子唯一所有且先科電子、泰邦電子及超偉並無有關ST商標使用權之分成安排。

我們訂立轉讓協議收購「ST」商標，乃由於我們的現有的部分客戶已批准本公司同時使用「Top Dynamic」名稱以及「ST」商標。我們的外盒設計變為僅使用「Top Dynamic」需該等客戶的重新批准。由於是否批准本公司的決定完全取決於我們的客戶，我們概不能確定重新批准之程序是否將於我們的預期時間表內完成或我們日後是否將能夠完全摒棄使用ST商標。

我們認為，根據轉讓協議收購ST商標與許可安排相比，考慮到許可人可終止使用ST商標之許可，符合本公司之利益。此外，誠如下文「一業務計劃」分節所載，儘管我們計劃於未來逐步停用ST商標，我們概不能確定所需之重新批准之程序是否可於我們的預期時間表內完成或我們日後是否將能夠完全摒棄使用ST商標。經考慮該項收購之代價金額及該項收購可產生之利益，主要是有關許可之使用條款的不確定因素可獲消除以及可提升經營的自主權，我們已決意進行收購而非申請許可，以此減少我們業務所面臨不可預見中斷之風險。

歷史、重組及集團架構

我們認為，儘管泰豐集團已透過超偉使用「ST」品牌名經營其電子零件業務超過十年之久，由於其產品與我們的產品存在差異，倘其決意擴大其產品範圍，則需購入機器以製造有關新產品，而此過程不可避免地要求進行資本投資，故其準備與我們訂立商標安排。此外，有關商標安排將允許泰豐集團就其業務繼續使用另外兩個先科電子商標。

承諾契據

我們由先科電子處得知，除本集團外，先科電子僅許可超偉及為超偉製造產品之工廠使用先科電子商標。由於另外兩個先科電子商標與ST商標存在部分相似性，為減低受由超偉等其他訂約方使用先科電子其他兩個商標所產生的不利報道的潛在影響的風險，先科電子於二零一五年六月二十二日以我們為受益人訂立承諾契據，據此，先科電子同意（其中包括）促使先科電子其他兩個商標的任何被授權人不得製造及／或銷售與我們產品規格類似的產品，惟倘乃透過我們或由我們協助完成者除外。具體而言，根據承諾契據，下列類別之半導體產品須遵守上述限制：

- 可分類為下列系列的所有半導體產品：DFN系列、SOD123FL、SOD123HE、SOD323、SOD323HE、SOT23、SOT26、LBF、TO277、TO277A
- 其技術水平於行業內通常被稱為「第四代或以上」的半導體產品
- 可分類為SOT系列，六個管腳，尺寸小於2.0毫米x1.25毫米x 0.95毫米，且屬於三通道產品或二極管陣列產品的半導體產品
- 可分類為TO系列，尺寸大於4.05毫米x5.3毫米x1.1毫米，且電流容量大於10安培的半導體產品

超偉及該等製造工廠將可就業務繼續使用先科電子商標（除ST商標外）。因此，先科電子認為於二零一五年六月自先科電子向本集團轉讓ST商標將不會對該等獲授權人造成任何重大影響。於實際情況中，由於先科電子為Chow Hin Keong先生及泰豐所控制，其將知悉由本集團及泰豐集團各自製造及銷售的產品類型。由此其可確保其能遵守承諾契據之條款。有關使用ST商標產生潛在負面影響的風險，請參閱本招股

歷史、重組及集團架構

章程「風險因素－與我們的業務有關的風險－任何可能從整體上對先科電子商標造成影響的不利報道或其他不利發展均可能對我們的業務、經營業績及財務狀況造成不利影響」分節。

業務計劃

經過近年來的業務發展，我們擬以我們自身的名稱營銷我們的產品，並於日後於我們的業務中逐漸減少使用ST商標。我們的董事現預期停止使用ST商標之預期時間約為二零一六年底。我們正與我們的現有客戶就本公司單獨使用我們的「Top Dynamic」名稱重新獲得批准所涉及之預期時間、程序及成本展開商討，並向該等我們認為將會批准我們單獨使用「Top Dynamic」之產品之現有客戶接洽並作出申請。我們已向部分現有客戶作出詢問並取得彼等之書面確認，彼等過往乃因我們的品名「Top Dynamic」而向我們採購產品，而非因另一品牌。我們於往績記錄期間內向其銷售產品的該等客戶佔我們截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零一五年三月三十一日止三個月總營業額逾80%。自二零一五年中旬至最後實際可行日期，我們已接洽若干名新客戶，並單獨使用我們的「Top Dynamic」名稱對其營銷。我們（作為賣方）已向我們的若干新客戶提呈申請以批准單獨使用「Top Dynamic」名稱。由於並非我們所有的客戶都要求我們在與彼等開展業務前須申請彼等之內部批准，故我們並無向我們所有的客戶呈遞申請。然而，由於決定是否批准本公司完全取決於我們的客戶，我們並不能確定該等重新申請程序是否將於我們的預期時間表內完成或我們於日後是否能完全摒棄使用ST商標。

我們與先科電子、超偉及泰豐集團的關係

於往績記錄期間，超偉為我們的五大供應商之一及客戶之一。自超偉之採購分別佔我們截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零一五年三月三十一日止三個月總採購額的約12.0%、27.2%及11.2%。我們主要向超偉採購玻封二極管及TO92產品。由於我們自身並不製造該類產品，我們自超偉採購該等產品以出售予我們的客戶。除超偉外，我們亦向我們的其他供應商採購類似產品。於決定向超偉或其他供應商採購該類產品時，我們考慮現行市場價格、質量及交付時間等因素。

歷史、重組及集團架構

截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零一五年三月三十一日止三個月，向超偉進行的銷售分別佔我們總營業額約5.7%、3.5%及3.0%。我們向超偉銷售的產品主要包括DFN1006及SOD123FL，其價格主要根據成本加我們管理團隊釐定之預期利潤率釐定。向超偉銷售的產品之利潤率與向我們其他客戶銷售同一產品之利潤率水平相似。

超偉為泰豐集團一間全資附屬公司。除超偉外，我們過去及現在均未與泰豐集團之其他成員公司進行業務交易。泰豐集團於先科電子持有50%的股本權益。

我們業務發展的里程碑

下表載列本集團業務發展的里程碑：

時間	業務成果
二零一二年十二月	Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生透過設立泰邦企業共同成立本集團，並開始於中國及香港與客戶買賣電源行業的產品
二零一三年一月	我們開始於韓國與客戶買賣顯示器行業的產品
二零一三年四月	東莞佳駿獲得營業執照
二零一三年八月	我們開始於台灣向客戶供應產品
二零一三年九月	我們在中國東莞市松山湖的生產設施開始生產經營，且我們開始於中國向客戶供應自行生產產品
	我們開始買賣家用電器行業及移動電話行業的產品
	我們的TD商標於香港註冊
二零一三年十月	我們開始於香港向客戶出售自行生產產品

歷史、重組及集團架構

時間	業務成果
二零一三年十一月	我們開始出售移動電話及電池組行業的自行生產產品
	我們開始於歐洲與客戶買賣產品
二零一三年十二月	我們開始向充電器行業的客戶出售自行生產產品
	我們開始買賣保健行業的產品
二零一四年三月	我們開始於歐洲向客戶出售我們的自行生產產品
二零一四年四月	我們開始於台灣向客戶出售自行生產產品
	我們開始買賣MP3及藍牙行業之產品以及打印機及LCD電視面板使用之產品
二零一四年八月	我們開始銷售移動電話充電器行業的自行生產產品
二零一四年十二月	我們開始銷售電腦主板行業、CCD照相機行業及移動表面貼裝行業的自行生產產品
二零一五年二月	我們開始出售我們顯示器行業的自行生產產品
二零一五年三月	我們開始出售我們家用電器行業的自行生產產品
二零一五年四月	我們開始於越南與客戶買賣旅行適配器及電池充電器行業的產品
二零一五年六月	我們的TD商標於日本註冊

企業歷史

本公司

本公司於二零一四年九月十日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立日期，本公司之法定股本為50,000港元，分為500,000股每股面值0.1港元之普通股，其中一股股份乃以未繳股款形式配發及發行予初始認購人（為獨立第三方），隨後於同日轉讓予Platinum Dynamic。於同一日，本公司另一股股份乃以未繳股款形式配發及發行予Silver Dynamic。於二零一四年十月三十日，本公司的中文名稱由「泰邦國際控股有限公司」改為「泰邦集團國際控股有限公司」。

根據重組，於二零一五年九月二十二日，本公司以32.3百萬港元（即TD Int'l (BVI)及其附屬公司於二零一五年三月三十一日之資產淨值）向Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生收購彼等各自於TD Int'l (BVI)擁有的50%股權，該款項乃透過(i)本公司向Platinum Dynamic及Silver Dynamic（為Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生各自的代名人）各發行1股本公司股份及(ii)本公司將Platinum Dynamic及Silver Dynamic各持有之未繳股款之本公司股份入賬列作繳足結清。

於二零一五年九月二十二日，我們的股東批准拆細，據此，每股面值0.10港元之已發行及未發行本公司股份拆細為十股每股面值0.01港元之股份。

於二零一五年九月二十二日，本公司透過增設1,995,000,000股於所有方面與當時現有股份平等的股份將法定股本由50,000港元增加至20,000,000港元。

於二零一五年九月二十二日，本公司按等價基準取得兩筆泰邦企業結欠Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生之金額各為30,000,000港元之貸款，因此，本公司結欠Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生兩筆金額各為30,000,000港元之貸款（「貸款」）。同日，本公司透過發行(i) 30,000,000股入賬為繳足之股份予Platinum Dynamic（為Chow Hin Keong先生之代名人）；及(ii) 30,000,000股入賬為繳足之股份予Silver Dynamic（為Chow Hin Kok先生之代名人）將貸款悉數資本化。

根據資本化發行及配售，本公司於緊接上市前已發行股份將為800,000,000股。

本公司主要從事投資控股。截至最後實際可行日期，本集團由本公司及其全資附屬公司（即TD Int'l (BVI)、TD(BVI)、泰邦企業、泰邦電子、德邦管理及東莞佳駿）組成。

本集團其他成員公司

TD Int'l (BVI)

TD Int'l (BVI)於二零零九年八月二十五日以一個曾用名於英屬處女群島註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股無面值股份。於其註冊成立後，1,000股股份以繳足形式以1,000美元發行予其第一名股東（為一名獨立第三方），隨後於二零一二年十一月三十日轉讓予Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生。於二零一五年九月二十二日，根據買賣協議，Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生將彼等各自於TD Int'l (BVI)的股權轉讓予本公司。因此，TD Int'l (BVI)成為本公司直接全資附屬公司，並主要從事投資控股。

TD (BVI)

TD (BVI)於二零零九年十月十三日以一個曾用名於英屬處女群島註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股無面值股份。於其註冊成立後，100股股份乃以繳足形式以100美元發行予其唯一股東TD Int'l (BVI)。TD (BVI)主要從事投資控股。

泰邦企業

泰邦企業於二零一二年七月十一日於香港註冊成立為私人有限公司。於其註冊成立日期，其股本中的一股股份乃以繳足形式以1.00港元之代價配發及發行予其初始認購人（為一名獨立第三方），隨後於二零一二年十二月十四日轉讓予TD (BVI)。因此，泰邦企業成為TD (BVI)的全資附屬公司。泰邦企業主要從事為本集團產品採購原材料及生產廠房和設備業務以及在中國境外銷售及分銷本集團產品。

泰邦電子

泰邦電子於二零一三年八月二十三日於香港註冊成立為私人有限公司。於其註冊成立日期，其股本中的一股股份乃以繳足形式以1.00港元之代價配發及發行予其唯一股東TD (BVI)。泰邦電子尚未展開任何業務營運並持有我們的註冊商標TD商標及ST商標。

德邦管理

德邦管理於二零一三年三月十八日於香港註冊成立為私人有限公司。於其註冊成立日期，其股本中的一股股份乃以繳足形式以1.00港元之代價配發及發行予初始認購人（為一名獨立第三方），隨後於二零一三年七月九日轉讓予TD (BVI)。因此，德邦

歷史、重組及集團架構

管理成為TD (BVI)之全資附屬公司。德邦管理主要從事提供本集團內公司間的管理服務。

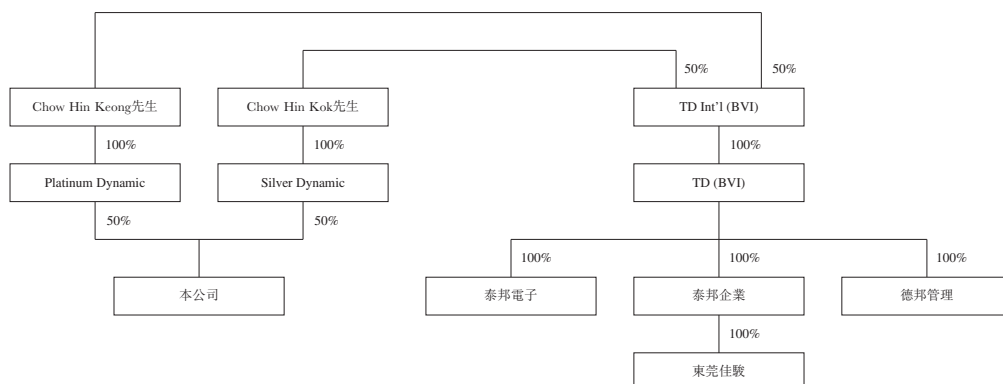
東莞佳駿

東莞佳駿於二零一三年四月二十七日於中國成立為有限公司，且其全部股權由泰邦企業全資擁有。東莞佳駿之初始註冊資本為8,000,000美元，乃於二零一五年一月二十三日悉數繳足。東莞佳駿於二零一三年九月開始運營，其主要於中國從事生產及銷售半導體產品及買賣其他半導體產品業務。

重組

本集團之企業架構

下圖列示本集團於緊接重組前之企業架構：



重組

本集團為籌備上市而進行重組，據此，本公司成為TD Int'l (BVI)及其附屬公司之控股公司。於二零一五年九月二十二日，Chow Hin Keong先生、Chow Hin Kok先生與本公司訂立買賣協議，據此(i)Chow Hin Keong先生向本公司轉讓其於TD Int'l (BVI)的全部股權；及(ii)Chow Hin Kok先生向本公司轉讓其於TD Int'l (BVI)的全部股權。上述轉讓之總代價32.3百萬港元（即TD Int'l (BVI)及其附屬公司於二零一五年三月三十一日之資產淨值）乃由本公司透過(i)本公司向Platinum Dynamic及Silver Dynamic（為Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生各自的代名人）各發行1股本公司股份；及(ii)將Platinum Dynamic及Silver Dynamic各持有之未繳股款本公司股份入賬列作繳足結清。

歷史、重組及集團架構

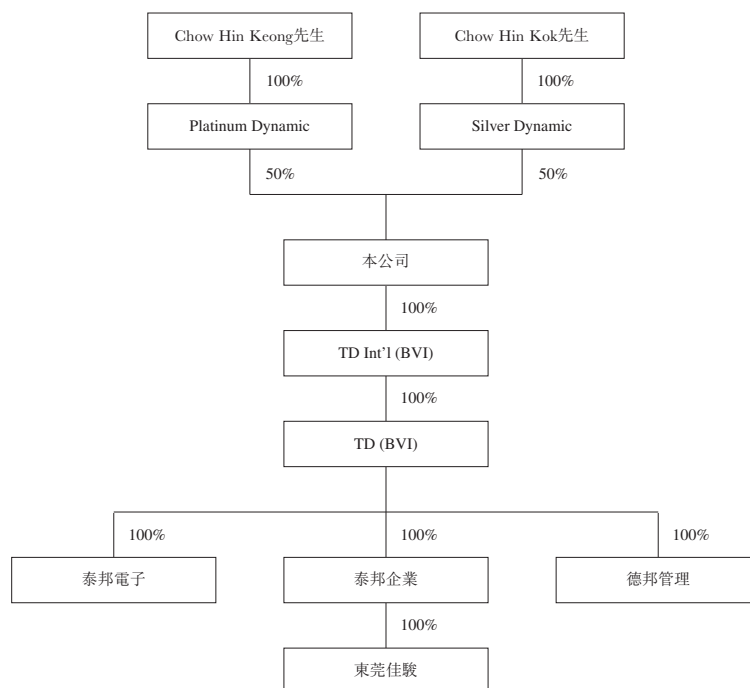
於二零一五年九月二十二日，我們的股東批准拆細，據此，每股面值0.10港元之已發行及未發行之本公司股份拆細為十股每股面值0.01港元之股份。

於二零一五年九月二十二日，本公司透過增設1,995,000,000股於所有方面與當時現有股份平等的股份將法定股本由50,000港元增加至20,000,000港元。

於二零一五年九月二十二日，本公司按等價基準取得兩筆泰邦企業結欠Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生之金額各為30,000,000港元之貸款，因此，本公司結欠Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生該兩筆貸款。同日，本公司透過發行(i) 30,000,000股入賬為繳足之股份予Platinum Dynamic（為Chow Hin Keong先生之代名人）；及(ii) 30,000,000股入賬為繳足之股份予Silver Dynamic（為Chow Hin Kok先生之代名人）分別將貸款悉數資本化。

根據資本化發行及配售，本公司於緊接上市前已發行股份將為800,000,000股。

下圖列示重組完成後本集團的股權及企業架構：



中國法規合規情況

我們的中國法律顧問確認，重組並不違反適用之中國法律法規且進行重組無須獲中國監管部門批准或許可，其亦確認，上市無須獲得中國當局（包括商務部及中國證券監督管理委員會）批准。

匯發37號規定中國居民在向特殊目的公司（即中國居民以在境外進行投資或融資為目的而直接設立或控制的特殊目的企業）注入資產或股權前，應向所在地外匯分局進行登記。初步登記後，特殊目的公司發生任何重大變更（其中包括中國居民股東、特殊目的公司名稱或營業期限的任何重大變更或特殊目的公司發生增資或減資、股權轉讓或置換、合併或分立等重大變更事項），中國居民亦應向所在地外匯分局登記變更。倘未遵守匯發37號的登記程序，或會受到處罰及制裁，包括對特殊目的公司的中國附屬公司向其境外母公司派付股息之能力施加限制。有關「中國居民」及「特殊目的公司」之詞彙定義，請參閱本招股章程「法規概覽」一節。

我們的中國法律顧問告知，根據匯發37號之規定，Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生均非中國居民，彼等不受匯發37號之登記規定所規限。

歷史、重組及集團架構

下圖列示緊隨重組以及配售及資本化發行完成後本集團之股權及企業架構，但無計及任何因根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使而將予配發及發行之股份：

